



Broadcom (AVGO.US)

2027년 AI 매출액 가이드선 유지

- 2Q26FY 실적 기대치 소폭 상회, 3Q26FY AI 매출액 가이드선은 컨센서스 하회
- 2027년 AI 매출액 \$100B 이상이라는 기존 가이드선 유지
- 시장 참여자들에게 AI 수요에 대한 우려를 자극할 것으로 판단함.

2Q26FY 실적, 기대치 소폭 상회

Broadcom의 2Q26FY 실적이 매출액 \$22.2B(+15%QoQ, +48%YoY), EBITDA \$15.2B(+16%QoQ, +52%YoY)를 기록하며, 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 \$22.1B, EBITDA \$15.0B)를 소폭 상회했다. 주요 부문 중 AI 반도체 솔루션 매출액이 \$10.8B(+29%QoQ, +143%YoY)를 기록하며 성장률이 가속화됐으며, 3Q26FY에도 큰 폭의 성장세가 이어질 전망이다. Non-AI 반도체 부문은 계절적 성수기 영향이 반영됐으며, 브로드밴드, 서버 스토리지, 엔터프라이즈 네트워킹 등의 실적이 개선됐다.

3Q26FY AI 매출액 가이드선, 시장 컨센서스 하회

3Q26FY 가이드선은 매출액 \$29.4B(+33%QoQ, +84%YoY), EBITDA \$20.0B(+31%QoQ, +87%YoY)로 제시되며, 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 \$28.6B, EBITDA \$20.0B)에 부합했다. 그러나 AI 반도체 솔루션 매출액 가이드선은 \$16.0B(+49%QoQ, +208%YoY)로 제시되며 시장 컨센서스(매출액 \$17.2B)를 크게 하회했으며, 나머지 Non-AI 반도체 부문은 컨센서스를 상회하는 상반된 흐름을 보였다.

2027년 AI 매출액 가이드선 유지

Broadcom은 이번 컨퍼런스 콜을 통해 2026FY AI 반도체 솔루션 매출액 가이드선을 \$56B로 제시했고, 2027FY 매출액은 \$100B을 넘어설 것이라는 점을 강조했다. 이는 지난 분기에 제시했던 가이드선과 동일한 수준이다. 최근 북미 데이터센터의 60% 이상이 아직 착공되지 않았다는 내용의 언론 보도도 있었기 때문에, Broadcom의 이러한 가이드선은 시장 참여자들에게 AI 수요에 대한 우려를 자극할 것으로 판단한다.

▶ 현재주가 / 목표주가 컨센서스

현재주가('26.06.04): \$418.91
 목표주가 컨센서스: \$492.72

▶ 투자 의견 컨센서스



Stock Data

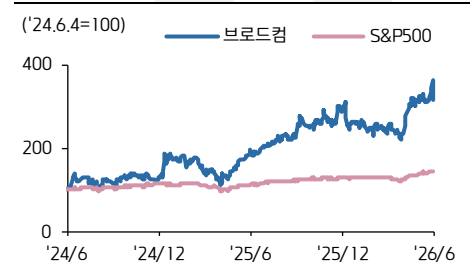
산업분류	반도체 & 반도체 장비
S&P 500 (6/4)	7,584.31
현재주가/목표주가	418.91 / 492.72
52주 최고/최저 (\$)	495 / 241.11
시가총액 (백만\$)	1,983,400
유통주식 수 (백만)	4,642
일평균거래량 (3M)	25,484,748

Earnings & Valuation

(백만 \$)	FY24	FY25	FY26E	FY27E
매출액	51,574	63,887	104,843	169,987
영업이익	30,736	41,997	69,833	111,775
OPM(%)	59.6	65.7	66.6	65.8
순이익	23,733	33,728	55,833	91,562
EPS	4.9	6.8	11.4	18.8
증가율(%)	15.3	40.0	66.5	65.2
PER(배)	101.5	75.4	36.9	22.3
PBR(배)	11.7	21.6	18.4	11.9
ROE(%)	51.8	45.3	51.9	54.8
배당수익률(%)	1.2	0.6	0.6	0.7

Performance & Price Trend

주가수익률 (%)	YTD	1M	6M	12M
절대	21.0	0.6	9.9	60.5
S&P Index	10.3	4.5	10.3	26.5



자료: 데이터 스트림 컨센서스, 키움증권 리서치센터

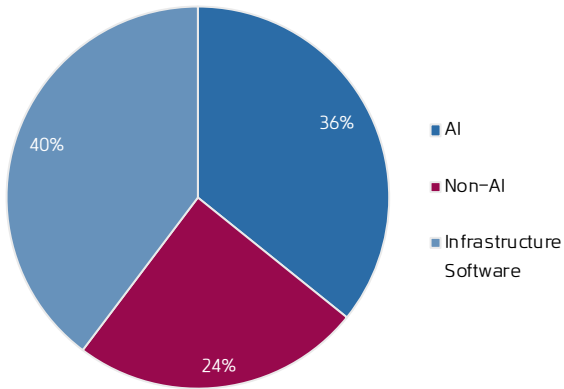
Broadcom 실적 추이 및 전망 (단위: 백만달러)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	15,004	15,952	18,015	19,311	22,187	29,487	34,234	36,415	68,282	122,323	187,701
%QoQ/%YoY	1%	6%	13%	7%	15%	33%	16%	6%	25%	79%	53%
Semiconductor Solutions	8,408	9,166	11,072	12,515	15,009	20,522	25,455	27,613	41,161	88,599	150,380
%QoQ/%YoY	2%	9%	21%	13%	20%	37%	24%	8%	33%	115%	70%
AI	4,400	5,200	6,438	8,400	10,800	16,407	21,174	23,377	24,438	71,758	128,381
%QoQ/%YoY	7%	18%	24%	30%	29%	52%	29%	10%	N/A	194%	79%
Non-AI	4,008	3,966	4,634	4,115	4,209	4,115	4,281	4,236	16,723	16,841	21,999
%QoQ/%YoY	-3%	-1%	17%	-11%	2%	-2%	4%	-1%	N/A	1%	31%
Infrastructure Software	6,596	6,786	6,943	6,796	7,178	8,648	8,877	8,845	27,121	33,548	37,133
%QoQ/%YoY	-2%	3%	2%	-2%	6%	20%	3%	0%	15%	24%	11%
매출원가	3,093	3,453	3,976	4,443	5,078	7,706	8,867	9,344	14,965	30,995	49,008
매출원가율	21%	22%	22%	23%	23%	26%	26%	26%	22%	25%	26%
매출총이익	11,911	12,499	14,039	14,868	17,109	21,780	25,367	27,071	53,317	91,327	138,693
영업비용	594	567	593	524	581	579	608	608	2,278	2,376	2,635
영업이익	9,793	10,455	11,921	12,826	14,928	19,707	22,921	24,460	44,995	82,016	126,301
%QoQ/%YoY	0%	7%	14%	8%	16%	32%	16%	7%	33%	82%	54%
영업이익률	65%	66%	66%	66%	67%	67%	67%	67%	66%	67%	67%
법인세차감전순이익	9,055	9,772	11,296	12,198	14,301	18,975	22,426	24,022	42,321	79,724	125,164
법인세비용	2319	1368	1582	2013	-2,041	3,115	3,728	3,995	7,282	8,797	21,547
당기순이익	6,736	8,404	9,714	10,185	16,342	15,860	18,698	20,027	35,039	70,927	103,617
당기순이익률	45%	53%	54%	53%	74%	54%	55%	55%	51%	58%	55%
CapEx	144	142	237	250	231	252	273	289	773	1,045	1,352
%QoQ/%YoY	44%	-1%	67%	5%	-8%	9%	8%	6%	47%	35%	29%
감가상각비	142	142	148	150	163	166	178	193	582	700	844
%QoQ/%YoY	0%	0%	4%	1%	9%	2%	7%	9%	-2%	20%	21%

주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2026/6/4). 실적은 Non-GAAP, CY 기준 (회계 기준 결산일은 10/31일)

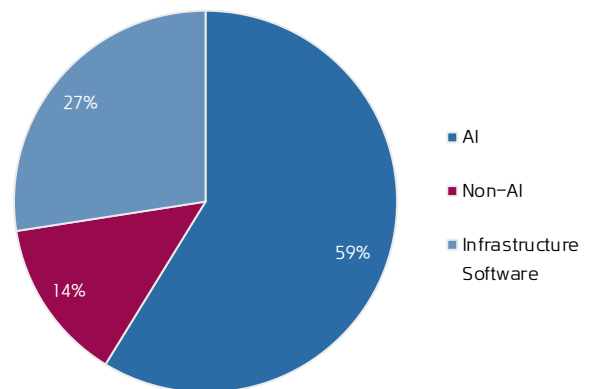
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2025CY Broadcom 매출액 비중



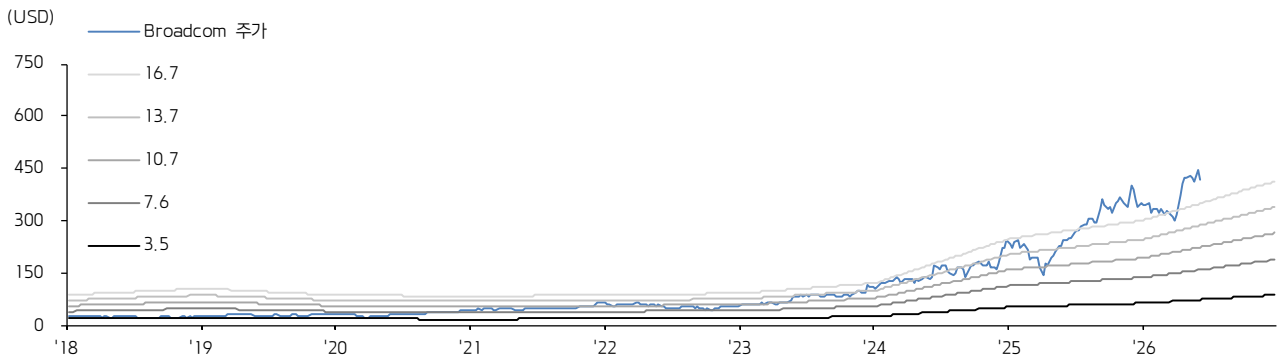
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2026CY Broadcom 매출액 비중 전망



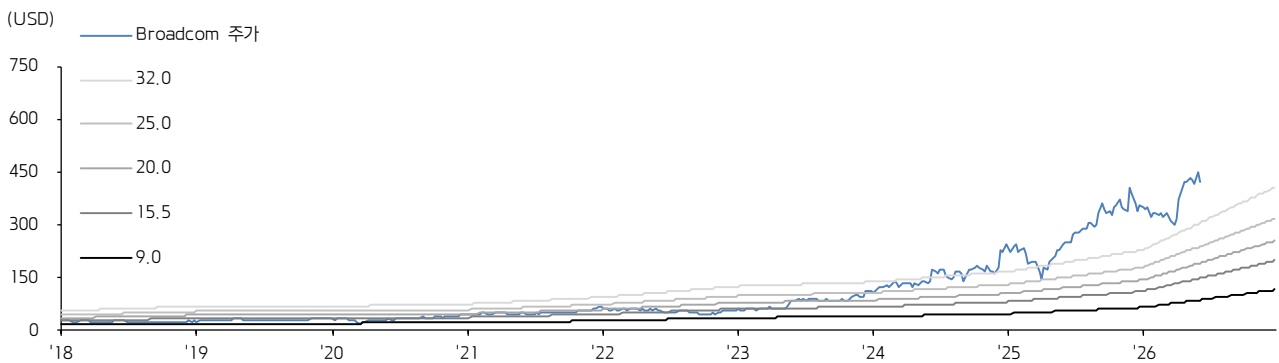
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Broadcom 12개월 Trailing P/B Chart



주: 6/4 증가 기준
자료: 키움증권 리서치센터

Broadcom 12개월 Trailing P/E Chart



주: 6/4 증가 기준
자료: 키움증권 리서치센터

글로벌 Tech 기업 추가 및 Valuation

(십억달러, 백, %)		Mkt Cap	%CHG				P/E		P/B		EV/EBITDA		Rev		OP		EBITDA		ROE		
	ID	5D	1M	3M	6M	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E		
Memory	Micron	1,123.2	-7.7	7.8	72.8	148.5	339.4	11.5	8.9	7.2	4.2	8.5	6.1	151.4	197.8	117.0	150.7	127.1	162.5	68.3	55.3
	Sandisk	260.6	-3.9	7.2	40.1	193.7	724.9	11.8	8.8	8.1	4.3	9.1	6.8	36.1	48.4	27.3	37.1	26.3	32.9	65.1	55.0
	Kioxia	262.6	-1.5	25.5	111.3	278.9	715.7	10.4	6.7	9.3	4.5	6.8	4.4	48.0	70.2	35.7	54.7	36.9	52.2	110.4	88.5
	Seagate	207.6	-1.6	5.1	25.4	146.9	248.6	43.7	28.8	53.8	23.8	33.1	21.5	14.2	18.6	6.0	9.1	6.2	9.4	278.3	147.7
	Western Digital	198.4	-3.1	8.3	30.1	120.2	257.5	41.9	27.9	16.6	12.0	28.6	17.9	15.1	20.3	6.4	9.6	6.8	10.7	59.5	65.7
	Nanya	43.3	-1.6	21.9	54.0	53.4	158.2	8.6	7.1	3.9	2.5	6.2	4.6	8.5	10.9	5.8	7.3	6.2	7.7	54.1	40.0
Logic	Intel	561.8	-0.8	-7.5	16.7	145.2	176.0	101.3	71.5	4.7	4.4	31.9	25.2	58.4	65.0	7.2	10.4	19.7	23.5	3.6	6.5
	Nvidia	5,291.6	1.9	2.1	10.2	19.5	19.2	25.4	17.5	18.4	11.3	20.5	13.9	378.4	544.4	251.7	363.3	253.4	359.1	89.1	73.0
	AMD	853.1	-3.6	1.0	53.2	158.9	142.2	71.9	39.8	12.0	10.3	61.4	34.0	49.5	74.9	13.9	25.2	14.2	25.1	14.5	22.0
	Broadcom	1,983.4	-12.6	-1.8	0.6	31.9	9.9	32.8	20.6	16.8	10.4	25.1	15.4	115.7	181.8	77.5	122.1	79.0	124.3	57.7	60.9
	Marvell	276.8	4.9	54.5	93.3	305.2	222.3	81.5	51.0	15.8	13.4	63.9	42.8	11.1	16.3	4.1	6.4	4.3	6.4	12.1	12.6
	Qualcomm	255.7	-2.6	-0.3	44.1	73.9	39.1	24.4	22.1	10.6	9.8	19.0	18.5	40.9	43.4	12.2	13.2	13.7	14.2	47.5	39.1
	Arm	420.2	-4.5	17.4	93.6	217.0	180.0	196.5	140.7	42.1	32.5	156.9	114.6	5.6	7.3	2.4	3.3	2.7	3.6	18.8	21.6
	Skyworks	12.0	-0.9	-1.8	16.1	42.0	15.8	16.4	15.2	2.2	2.2	9.9	8.7	3.9	4.1	0.8	0.9	1.2	1.4	9.1	9.6
	TI	277.9	-1.0	-3.3	8.7	50.9	69.5	39.5	33.2	15.2	14.2	26.2	22.4	21.0	23.3	8.4	9.9	10.8	12.7	40.3	43.7
	ADI	208.8	-2.0	2.3	8.0	25.5	54.6	32.8	28.2	6.0	5.5	25.2	22.3	15.3	17.2	7.5	8.7	8.4	9.5	16.1	18.2
	NXP	81.4	0.1	-2.4	10.8	48.9	42.5	22.0	18.3	6.8	5.8	15.9	13.3	14.0	15.5	4.9	5.7	5.6	6.5	32.2	32.7
	STMicro	71.4	-1.7	12.8	42.1	135.1	205.4	61.4	30.6	3.8	3.5	21.2	14.1	14.2	16.6	1.3	2.7	3.3	4.8	6.1	11.4
	Microchip	52.2	-0.3	0.3	1.0	37.8	48.8	33.6	25.1	8.3	7.2	25.9	18.4	5.9	7.0	2.0	2.7	2.2	3.1	19.4	27.8
	On Semi	51.7	-1.6	6.5	29.2	110.8	140.6	42.7	31.0	7.1	6.5	24.4	20.2	6.5	7.2	1.4	1.9	2.1	2.6	15.9	22.7
	Silicon Motion	10.0	-3.9	4.3	29.7	140.9	223.7	35.1	28.8	9.4	7.3	26.6	20.2	1.6	1.8	0.3	0.4	0.4	0.5	29.0	29.7
Mediatek	225.8	-2.5	0.5	40.4	149.6	210.9	67.3	36.7	16.6	13.4	53.7	29.5	20.6	31.9	3.3	6.6	4.1	7.4	25.9	41.9	
Renesas	56.6	0.3	12.4	51.0	84.4	133.7	21.5	19.0	3.2	2.9	18.1	16.0	9.6	10.4	2.0	2.2	3.3	3.6	14.5	11.9	
Novatek	9.5	-2.8	2.2	16.4	30.6	26.4	16.9	15.4	4.1	3.9	11.7	10.2	3.4	3.7	0.6	0.7	0.7	0.8	25.5	26.4	
Foundry	TSMC	2,307.6	1.9	4.7	10.8	24.5	51.9	28.5	22.7	9.7	7.4	18.4	14.4	165.2	209.1	94.7	118.8	120.2	151.4	38.4	36.5
	SMIC	102.4	-1.7	-7.6	15.1	32.5	16.8	78.2	57.8	3.7	3.4	20.9	17.6	11.5	13.5	1.3	1.8	6.0	7.1	4.7	5.8
	UMC	52.3	-2.9	-8.3	60.2	110.4	164.2	32.5	29.3	6.7	6.4	N/A	N/A	8.7	9.9	1.8	2.4	3.9	4.6	15.1	15.4
	GFS	46.5	-1.5	5.0	25.0	78.1	125.4	44.2	33.3	3.8	3.5	17.8	14.7	7.3	8.0	1.2	1.6	2.5	3.0	8.3	10.2
	VIS	9.7	-3.0	0.9	5.8	36.4	76.6	28.0	24.7	3.6	3.3	16.3	13.7	1.8	2.3	0.4	0.4	0.7	0.9	14.5	14.7
Packaging	ASE	85.6	-3.8	-5.4	19.0	73.8	153.3	36.7	25.7	N/A	N/A	N/A	N/A	25.1	29.6	2.9	4.1	5.4	7.2	19.4	N/A
	Amkor	18.3	-1.8	4.6	4.0	61.3	71.0	35.3	30.5	3.6	3.3	13.9	12.2	7.6	8.5	0.7	0.8	1.4	1.6	11.2	11.1
	Agilent	39.1	0.7	2.2	23.3	14.8	-6.7	22.5	20.8	5.0	4.4	17.7	16.1	7.5	7.9	2.0	2.2	2.2	2.4	23.1	22.0
	Chipbond	6.4	-1.5	-2.5	52.7	416.2	412.3	53.0	39.0	4.0	3.8	28.1	23.4	0.8	0.9	0.1	0.2	0.2	0.3	7.9	10.3
	Equipment	ASML	682.2	1.8	9.4	26.8	25.6	58.3	48.0	36.3	24.4	18.1	37.8	28.5	45.5	55.4	16.5	21.8	17.7	23.2	55.3
AMAT		398.3	0.2	11.6	28.2	40.2	86.2	38.1	28.9	14.8	12.2	32.1	24.5	35.3	43.7	11.7	15.2	12.3	16.0	42.2	44.6
LAM Research		420.7	-2.1	5.8	30.1	50.9	114.2	48.8	38.3	28.4	20.0	40.6	31.9	26.9	32.9	9.9	12.6	10.3	13.0	67.4	65.1
TEL		186.2	4.5	21.7	34.2	52.6	92.1	40.1	36.2	12.6	10.7	31.1	24.5	19.4	22.8	5.4	6.6	5.9	7.4	31.3	34.2
KLA		278.4	0.3	10.6	24.4	44.4	76.4	49.2	38.2	38.3	28.1	39.5	30.8	15.2	18.4	6.7	8.5	7.1	9.0	92.1	85.8
AMEC		40.0	1.2	-4.8	14.6	26.6	57.5	82.5	58.9	10.5	8.9	74.3	50.1	2.4	3.2	0.5	0.7	0.5	0.8	13.0	15.8
Naura	67.1	2.0	-4.9	16.8	34.5	39.2	54.7	40.0	10.1	8.0	44.8	32.3	7.4	9.5	1.3	1.8	1.5	2.1	18.4	20.9	
Materials	Linde	234.3	-2.0	1.1	3.5	1.7	26.3	28.4	25.9	5.9	5.6	18.2	17.0	35.9	37.7	10.7	11.5	14.2	15.2	20.7	21.5
	Air Liquid	122.2	1.0	-0.2	2.3	5.4	11.3	25.9	23.5	3.7	3.5	13.4	12.4	32.6	34.2	7.1	7.7	10.1	10.9	14.9	15.3
	Air Products	63.0	0.2	-0.3	-5.2	3.2	8.1	20.9	19.5	3.5	3.2	15.4	13.9	13.0	13.7	3.2	3.5	5.4	5.9	17.8	17.7
	Merck KGaA	70.4	4.5	7.3	27.5	13.4	16.8	17.9	16.5	2.0	1.8	11.4	10.4	24.4	25.5	4.4	4.9	6.9	7.3	10.7	11.3
	ADEKA	2.6	-3.2	-5.3	3.9	-7.9	11.5	14.5	12.8	1.2	1.2	6.7	7.7	2.8	2.4	0.3	0.3	0.4	0.3	9.1	9.2
	Resonac	20.6	-4.5	-3.5	27.2	49.0	187.4	33.9	25.2	4.2	3.7	15.5	12.7	8.9	8.6	0.9	1.2	1.6	1.9	13.4	16.3
	Siltronic	3.5	-3.0	6.4	26.0	87.4	103.4	N/A	N/A	1.9	2.1	14.8	10.5	1.5	1.7	-0.2	-0.1	0.3	0.5	-12.0	-9.3
Sumco	9.6	-2.1	30.4	72.4	158.2	216.5	N/A	64.6	2.8	2.7	14.5	11.7	2.7	2.9	-0.1	0.2	0.8	1.0	-3.3	3.8	
Server	Dell	274.2	0.2	33.1	99.4	186.9	203.7	23.8	20.9	695.9	60.6	16.2	14.5	163.2	185.3	15.2	17.5	17.9	19.6	-487.8	51.7
	HPE	71.1	-2.6	40.5	87.0	149.1	134.5	14.9	13.3	2.7	2.4	8.9	7.9	45.9	49.5	6.5	7.3	9.6	10.3	18.9	19.5
	Lenovo	39.6	-4.4	27.0	114.8	171.1	149.3	19.4	17.9	4.4	3.6	8.7	7.2	91.6	99.7	3.7	4.3	4.5	5.1	28.1	27.7
	Quanta	49.6	-3.1	31.0	25.9	39.6	35.8	17.1	14.3	5.9	5.2	13.6	11.6	112.8	139.2	3.5	4.3	3.9	4.8	34.9	37.6
	Inspur	13.7	-1.3	-4.6	-9.2	6.8	3.3	26.4	19.6	3.7	3.1	24.5	18.7	29.0	35.9	0.6	0.7	0.6	0.8	14.4	16.2
	Wiwynn	32.9	-0.5	12.5	17.1	32.0	18.9	16.2	12.1	6.0	4.8	11.5	8.9	40.7	62.5	2.6	3.6	2.8	3.7	43.3	43.3
	Inventec	8.9	-8.9	21.8	65.7	85.7	65.2	25.5	20.6	3.8	3.8	16.4	14.2	25.9	28.8	0.5	0.6	0.7	0.8	14.5	17.3
	Mitac	4.0	-6.1	13.0	11.7	15.4	0.2	13.2	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	5.5	8.3	0.3	0.4	0.4	0.5	12.6	15.2
CSPs	Amazon	2,730.0	1.5	-7.4	-6.7	17.1	10.8	24.6	21.9	5.1	4.0	13.1	10.6								

Broadcom 관련 용어

용어	이미지	설명
GPU		컴퓨터 그래픽 처리 장치로, 수천 개의 작은 코어로 병렬 처리를 수행해 AI 가속기로 활용
XPU		범용 GPU와 달리 특정 워크로드에 적합한 아키텍처로 설계된 연산 장치
TPU		Google이 AI 학습 및 추론을 위해 자체 설계한 AI 가속기
Ironwood		Google의 최신 7세대 TPU
Networking Switch		네트워크 단위들을 연결하는 통신 장비
Tomahawk 6		Broadcom이 개발한 세계 최초의 102.4Tbps 이더넷 스위치 칩
Ethernet		컴퓨터와 부품들을 유선으로 연결하여 데이터를 주고받는 네트워크 기술 표준
DSP		AI, 데이터센터 등 고대역폭 광통신 연결을 위한 디지털 신호 처리 칩
VMware		Broadcom이 지원하는 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어 제품
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)		공급업체가 설계부터 제조까지 외주로 공정을 관리하는 방식
COT (Customer Owned tooling)		고객사가 직접 설계 데이터를 제공하고 공정 전 과정을 관리하는 방식
Rack		서버나 통신 시스템을 구성하는 장비들을 탑재할 수 있는 규격 제품
CoWoS (Chip on Wafer on Substrate)		2개 이상의 칩을 웨이퍼 상에서 연결해 기판에 올리는 TSMC의 고급 2.5D 반도체 패키징 기술
Photonic Fabric		Celestial 시가 개발한 광 인터커넥트 기술
Pluggable Optics		네트워킹 장비에 삽입되어 전기 신호를 광섬유 전송을 위한 광자로 변환하는 플러그형 광학 장치
Silicon Photonics		실리콘 칩 위에 광자가 흐르는 통로를 만들어 전기 대신 빛으로 데이터를 전송하는 기술
Scale-up		기존의 서버를 보다 높은 사양으로 업그레이드하는 방법
Scale-out		기존의 서버를 추가로 확장하여 랙 단위로 연결해 증설하는 방법
Scale-across		기존의 데이터센터들을 연결하여 연산 용량을 늘리는 방법

자료: NVIDIA, Google, Broadcom, 키움증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- "브로드컴" 종목은 6월 1일 해외관심종목에 언급된 바 있습니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.